

中信证券股份有限公司
关于深圳天德钰科技股份有限公司
2024 年半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“天德钰”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 8 月 2 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度；

（3）查阅公司与控股股东及其关联方的交易明细及相关内部审议文件、信息披露文件及公司信用报告；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、公司出具的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；

（5）对公司高级管理人员进行访谈；

- (6) 对公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；
- (7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；
- (8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术创新的风险

随着 5G、物联网等技术的普及，电子产品性能日益提升且需求日益多样化，对芯片产品的性能提出了更高要求。若公司未能及时捕捉市场需求，或未能及时进行技术创新、开发出新产品，将面临错失市场发展机会的风险，或对公司未来发展及竞争力产生不利影响。

2、新产品研发失败的风险

为紧抓市场需求、加强终端客户导入力度，公司需要持续升级现有产品并开发新产品。产品的持续开发需投入大量的人力及财力，若公司对市场需求方向或技术方向发生误判，或研发过程中未对关键技术实现突破、研发结果未能达到预期效果，则存在研发失败的风险，进而无法收回前期研发投入，对公司财务状况产生不利影响。

3、核心技术泄密的风险

集成电路设计行业为技术密集型行业，核心技术是行业内企业保持领先优势的重要保障，对企业发展具有重要作用。尽管公司已经建立完善的人才制度，但仍存在因日常研发核心技术人员流失等导致的潜在的技术泄密风险，进而对公司业务发展造成不利影响。

（二）经营风险

公司的经营风险主要来源于市场价格竞争以及原材料成本波动等因素。

1、显示驱动相关领域行业竞争加剧的风险

随着国内液晶显示行业快速发展，显示驱动 IC 相关市场的竞争日趋激烈，同行业企业加速技术升级、产品优化。若未来行业竞争加剧，产品价格水平可能下滑，若公司未能及时推出新产品、提高管理水平以应对市场竞争，则存在因市场竞争加剧导致盈利下滑的风险。

2、晶圆供应周期性波动的风险

公司作为集成电路设计企业，采用 Fabless 经营模式，将晶圆制造与封装测试环节由晶圆厂及封测厂完成。在半导体产业供需关系波动的影响下，上游晶圆制造产能相对紧缺。目前，公司通过积极拓展多方晶圆供应渠道等方式，在一定程度上维持了晶圆供应的稳定性。若市场景气度上升，下游市场需求旺盛导致产能紧张晶圆供应可能无法满足需求，将对公司经营业绩的稳定性产生不利影响。

3、新产品开发及时性的风险

公司业绩增长既受益于行业供需变化的影响，亦受益于新产品不断研发成功并实现量产的影响。随着下游客户需求不断多样化，如 Micro-OLED 等新型显示材料逐渐商业化、客户对手机等电子产品更加追求轻薄化、多功能化等，对芯片功能及性能要求更高，研发设计难度随之提高，若公司未来不能及时研发出新产品或研发的产品不能满足市场需求，则营业收入及盈利水平将无法继续保持较高增长的风险。

（三）财务风险

1、存货跌价风险

本持续督导期期末，公司存货金额较大，受未来市场需求变化、产品迭代、价格变化等不确定因素影响，若公司未来不能合理控制存货规模，优化库存结构，可能会使公司面临或增加存货积压、发生跌价的风险。

2、汇率波动的风险

公司的记账本位币为人民币。本持续督导期间内，公司存在境外采购及销售的情况，并主要通过美元等外币进行结算。虽然公司在经营过程中重视外币资产和外币负债在规模上的匹配，同时考虑了订单处理及款项收付之间汇率可能产生的波动，但公司难以预判未来经济环境、货币政策、政治形势的变化，难以预判未来人民币与美元等外币之间汇率波动的形势。若未来美元等外币汇率发生大幅波动，可能会使公司面临或增加较大的汇兑损失风险，影响利润水平的波动，对公司未来经营业绩的稳定造成不利影响。

（四）行业风险

公司深耕集成电路设计行业多年，围绕移动智能终端领域进行深入布局，产品线涵盖移动智能终端显示驱动芯片、电子价签驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片及快充协议芯片。行业需求及下游应用领域发展向好。但近年来，随着行业内企业尤其中国大陆企业参与者持续增多，行业竞争日趋激烈。若公司未来未能及时进行产品性能改进或及时推出新产品，将存在因市场竞争日趋激烈导致的市场份额下滑、毛利率下滑的风险。

（五）宏观环境影响

集成电路行业为国民经济重要行业，其发展受宏观经济波动影响。公司主营产品广泛应用于手机、平板、智能音箱、智能穿戴、快充/移动充电、智慧零售等领域，不可避免地受到宏观经济波动、下游需求变化的影响。若未来宏观经济继续波动，下游需求出现剧烈变化，将会间接导致公司产品销量波动或产品结构调整。目前，集成电路行业获得国家政策支持，发展相对较快。但若未来国内集成电路产业政策发生变化，将对集成电路行业带来影响，进而影响公司业务发展。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年上半年，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2024年半年度	2023年半年度	本期比上年同期增减(%)
营业收入	84,281.15	50,246.35	67.74
归属于上市公司股东的净利润	10,098.38	4,662.91	116.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,414.64	4,223.48	99.23
经营活动产生的现金流量净额	5,681.28	17,156.00	-66.88
主要会计数据	2024年6月末	2023年6月末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	198,871.91	187,294.44	6.18
总资产	235,386.98	208,487.40	12.90
主要财务指标	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.25	0.11	127.27
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.11	127.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.10	110.00
加权平均净资产收益率(%)	5.11	2.52	增加2.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.26	2.29	增加1.97个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	9.34	13.17	减少3.83个百分点

1、2024年半年度公司营业收入为84,281.15万元，较上年同期增长67.74%，主要系本持续督导期间内公司智能移动终端显示驱动芯片产品、电子价签驱动芯片产品客户需求增加所致。

2、本持续督导期间内，归属于上市公司股东的净利润为10,098.38万元，较上年同期增长116.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,414.64万元，较上年同期增长99.23%，主要系智能移动终端显示驱动芯片产品、电子价签驱动芯片产品营业收入增加所致。

3、本持续督导期间内，公司经营活动产生的现金流量净额5,681.28万元，较上年同期下降66.88%，主要系上期发生产能保证金抵货款所致。

4、基本每股收益和稀释每股收益为 0.25 元，较上年同期增长 127.27%，主要系本持续督导期间内公司净利润增加所致。

5、扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.21 元，较上年同期增长 110.00%，主要系本持续督导期间内公司净利润增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

根据公司 2024 年半年度报告，公司的核心竞争力如下：

1、研发实力较强

公司研发实力较强，开发技术能力也是公司最重要的核心竞争力。公司的研发团队较稳定，核心技术人员均具有多年丰富的项目开发经验。公司研发团队经过多年的产品迭代和技术创新，积累了较深厚的技术基础，研发项目系统化运作效率较高，开发速度较快，并能保持灵活性，能快速响应市场变化。公司定期对研发进度和成果评估，不断总结沉淀积累技术果实，形成目前较强的研发实力。

2、系统化精细管理，全产全销，效率较高

公司运营管理系统化较高，特别是供应链系统化管理效率较高，决策较快。从晶圆加工到封装测试的整个流程，从原材料、半成品到产成品，不同的产品、型号、工序、供应商，庞大的数据和复杂的流程，经过系统精细化的流程设计和团队的熟练使用，做到全产全销，周转效率较高。

3、完善供应链布局，保证产能及时交付

公司十分重视供应链能力的建设，在供应商选择上寻求与产业链领先的厂商合作，并与上游晶圆制造商、封装测试厂商等供应商建立了高效和长期稳定的合作关系。供应链布局完善保障了产能的自主可控。公司主要晶圆供应商及主要封装测试供应商主要为行业里知名企业，不仅拥有先进的生产工艺以保障产品的良率和一致性，而且均为本土合作伙伴，有利于公司供应链自主可控，能够有效保障公司的产能供给。

4、覆盖全球优质客户

公司凭借稳定的产品质量、优异的客户服务能力，积累了良好的国内外终端客户资源。目前，公司产品应用领域覆盖移动手机、平板、智能音箱、智能穿戴、快充/移动电源、智能零售、智慧办公、智慧医疗等领域，公司产品种类丰富，可以满足上述应用领域的多样化需求。公司注重与下游模组厂、面板厂、系统厂及终端客户的合作及服务，已与 BOE、群创光电、华星光电、合力泰、清越电子、国显科技、星源电子、华勤通讯、闻泰科技、龙旗通讯等知名下游企业建立了稳定的合作关系，产品广泛应用于三星、VIVO、OPPO、荣耀等手机品牌；亚马逊、谷歌、百度、小米等平板、智能音箱客户；360、Tik Tok 等智能穿戴客户。优质的全球客户资源，有利于公司扩大现有产品业务规模及更快的推出新技术、新产品，为公司长远发展打下坚实基础。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	7,875.29	6,617.27	19.01
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	7,875.29	6,617.27	19.01
研发投入总额占营业收入比例 (%)	9.34	13.17	减少 3.83 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

（二）研发进展

公司在研项目情况如下：

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	低成本单 C 口快充协议芯片	1,350.00	340.5	552.89	在研	支持 PD3.1-SPR，并具有高兼容与高集成特性以及外围低成本的快充协议芯片	国内先进	手机、平板、移动电源、旅充、墙充、排插等充电装置
2	双 C 口快充协议芯片	1,300.00	391.44	391.44	在研	内置 MCU 高集成 PD 控制器，支持二组 USBType-c，外围简洁，设计简单，支持 USBPD3.1EPR-140W(28V/5A)、AVS、UFCS、QC5.0(向下兼容)、SCP、FCP 等快充协议，高精度 CV/CC 控制，可编程的过流过压过热等保护措施，也可通过软件设定来实现智能分配功率，二组 FBO/OPTO 可同时提供定制化多种输出功率，以提高使用便利性	国内先进	手机、平板、移动电源、旅充、墙充、排插等充电装置
3	高压降压同步控制芯片	1,500.00	259.90	825.50	在研	40V 高压降转电压转换器，具有 CC/CV 功能可作定电流定电压的充电	国内先进	车充、多口旅充
4	四色 (176X296) 电子标签显示屏驱动芯片	1,200.00	576.16	779.86	在研	支持四色分辨率 176X296 电子标签显示屏驱动芯片,预计更加提升画面刷新速度表现、最适性的温度范围区间,能满足 ESL 多元环境需求	国内先进	电子标签显示屏驱动芯片
5	qHD 整合型触控显示驱动芯片	1,026.18	258.27	771.36	在研	研发工控高分辨率的大屏幕解决方案，兼容 LVDS/MIPI/RGB 接口，并提供正正压/正负压等多种双边驱动玻璃设计规范，并节省工控芯片成本，为终端客户提供全方位设计的解决方案	国内先进	智能手机等消费电子

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
6	HD 高刷新率智能手机显示屏触控驱动整合芯片	2,650.00	258.27	708.94	在研	研发 A-Si 玻璃高刷新率(144Hz)以及高报点率(240Hz), 通过电路优化 AFE 架构以及算法处理, 提升触控效能;并透过动态帧率功能以达到功耗节能;另下沉式 pad 设计,为终端客户提供HD 占屏率的解决方案。	国内先进	智能手机等消费电子
7	HD720X1680 整合型触控显示驱动芯片	2,760.00	689.39	689.39	在研	研发 A-Si 玻璃高刷新率(144Hz)以及高报点率(240Hz), 通过电路优化 AFE 架构以及算法处理, 提升触控效能;并透过动态帧率功能以达到功耗节能;另 normalpad 设计,为终端客户提供HD 占屏率的解决方案	国内先进	平板/智能音箱、智能工控等显示屏芯片
8	平板 stylus 显示屏触控驱动芯片	6,349.00	173.56	4,895.98	在研	研发 A-Si/LTPS/IGZO 玻璃高刷新率(15Hz~144Hz)以及高报点率(240Hz)通过电路优化 AFE 架构以及算法处理, 提升触控效能。并透过动态帧率功能达到功耗节能;主动笔也兼容各家专属协议以及 DPHY/DSC/CPHYinterface 设计, 为终端客户提供平板大屏的解决方案	国内先进	平板/智能音箱、智能工控等显示屏驱动芯片
9	多接口 TFT 穿戴显示屏触控驱动芯片	520.00	67.79	498.62	在研	智能穿戴装置显示屏驱动芯片分辨率 360X390, COFLINE 设计, 兼容多接口新一代功耗节能, 为终端客户提供多面向的解决方案	国内先进	智能手机、智能穿戴等消费电子
10	图像处理芯片 BridgeIC	2,900.00	686.80	686.80	在研	此系列产品能通过高端核心技术替代 FPGA, 以最佳化的设计架构和工艺节点, 通过高端核心技术, 实现超低功耗, 能够大规模地支撑显示需求。	国内先进	手机、消费电子移动装置
11	超静音 APOIS 音圈马达驱动芯片	1,100.00	408.19	408.19	在研	兼容不同类型 VCM, 超低静音	国内先进	手机、平板、安防、相机

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
12	用于 USB Cable 的 E-Marker 芯片	1,100.00	204.62	204.62	在研	具有电子标签 ID 识别功能, 让充电线缆识别 240W 充电功率	国内先进	用于各式移动装置之充电线缆
13	四色 (200X384) 电子标签显示屏驱动芯片	1,200.00	535.87	535.87	在研	支援四色分辨率 200X384 电子标签显示驱动芯片, 预计更加提升画面刷新速度表现、最适性的温度范围区间, 能满足 ESL 多元环境需求。	国内先进	电子标签显示屏驱动芯片
14	数码 TFT132X162 显示驱动芯片	1,320.00	604.05	604.05	在研	支持 TFT132X162。随着 TFT 普及越来越高。小尺寸的驱动需求日益增加, 增强扩充 SPI/MCU 应用范围	国内先进	手机、消费电子移动装置
15	四色 (240X480) 电子标签显示屏驱动芯片	1,460.00	309.97	309.97	在研	支援四色分辨率 240X480 电子标签显示驱动芯片, 预计更加提升画面刷新速度表现、最适性的温度范围区间, 能满足 ESL 多元环境需求。	国内先进	电子标签显示屏驱动芯片
16	HD720X1680 增强型触控显示驱动芯片	2,980.00	365.71	365.71	在研	研发 A-Si 玻璃高刷新率(120Hz) 以及高报点率(240Hz), 通过电路优化 AFE 架构以及算法处理, 提升触控效能。并透过动态帧率功能以及 4power 模式玻璃分区变频达到功耗节能。另下沉式 pad 设计, 为终端客户提供 HD 占屏率的解决方案。	国内先进	智能手机等消费电子
17	四色 (128X250) 电子标签显示屏驱动芯片	1,220.00	209.25	209.25	在研	支援四色分辨率 128X250 电子标签显示驱动芯片, 预计更加提升画面刷新速度表现、最适性的温度范围区间, 能满足 ESL 多元环境需求	国内先进	电子标签显示屏驱动芯片
18	USB-PD 控制芯片	850.00	44.67	44.67	在研	首创固件化快充协议控制芯片, 组 FBO/OPTO 可同时提供客制化多种输出功率, 以提高使用便利性	国内先进	车充、旅充、墙充、排插等充电装置

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
19	HD720X1680 整合型高刷新率触控显示驱动芯片	2,330.00	127.26	127.26	在研	研发 A-Si 玻璃 TDDI 整合芯片 qHD 分辨率,高刷新率(90Hz)以及高报点率(120Hz)通过电路优化 AFE 架构以及算法处理,提升触控效能	国内先进	智能手机等消费电子
20	AMOLED 智能手机装置显示屏驱动芯片	2,800.00	241.07	241.07	在研	透过动态高低帧率切换亮度补偿功能,改善显示屏在高低帧率切换时容易发生的亮度抖动问题,采用不同帧率切换时动态调整屏幕驱动电压与亮度开启时间的方式,即可配合不同屏幕的特性,将高低帧率切换亮度抖动的问题改善。本技术为实时性补偿功能,透过动态电压与亮度开启时间的调变,使人眼在任何亮度环境下切换高低帧率都不会因为屏幕亮度变化对人眼造成不适。	国内先进	智能手机等消费电子
合计	/	37,915.18	6,752.73	13,851.43	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间,保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件,对公司高级管理人员进行访谈,基于前述核查程序,保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间,保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账,并对大额募集资金支付进行凭证抽查,查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件,实地查看募集资金投资项目现场,了解项目建设进度及资金使用进度,取得公司出具的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,对公司高级管理人员进行访谈。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议并通过了《关于首次公开发行募投项目延期的议案》,综合考虑公

司当前募集资金投资项目的实施进度等情况，同意公司对募投项目“移动智能终端整合型芯片产业化升级项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 6 月延期调整为 2025 年 6 月。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目的建设内容、投资规模、用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

天德钰无实际控制人，截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东恒丰有限公司的持股数量为 223,216,115，本持续督导期间内不存在减持，亦不存在质押、冻结的情况。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

姓名	职务	年初持股数	2024 年 6 月 30 日持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	质押或冻结
郭英麟	董事长	442,500.00	442,500.00	-	不适用	否
梅琮阳	董事	306,003.00	306,003.00	-	不适用	否
施青	董事	-	-	-	不适用	否
蔡坤宪	董事	-	-	-	不适用	否
Kwang Ting Cheng	独立董事	-	-	-	不适用	否
韩建春	独立董事	-	-	-	不适用	否
陈辉	独立董事	-	-	-	不适用	否
陈柏苍	监事会主席	-	-	-	不适用	否
郭初方	监事	-	-	-	不适用	否
张依	职工代表监事	-	-	-	不适用	否

姓名	职务	年初持股数	2024年6月30日持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	质押或冻结
邓玲玲	董事会秘书	77,500.00	77,500.00	-	不适用	否
王飞英	市场总监	-	-	-	不适用	否
谢瑞章	副总经理	307,500.00	307,500.00	-	不适用	否
李荣哲	核心技术人员	87,282.00	87,282.00	-	不适用	否
梁汉源	核心技术人员	59,741.00	59,741.00	-	不适用	否
蔡周良	核心技术人员	59,851.00	59,851.00	-	不适用	否
合计	/	1,340,377.00	1,340,377.00	-	\	\

除上述情况外，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

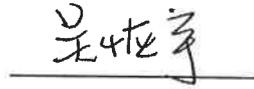
十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

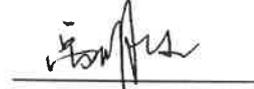
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人：



吴恢宇



禹明旺

